

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 26 年 9 月 11 日 (2014.9.11)

【公開番号】特開 2013-93386 (P2013-93386A)

【公開日】平成 25 年 5 月 16 日 (2013.5.16)

【年通号数】公開・登録公報 2013-024

【出願番号】特願 2011-233288 (P2011-233288)

【国際特許分類】

H 0 5 K 3/46 (2006.01)

H 0 5 K 3/24 (2006.01)

F 2 1 S 2/00 (2006.01)

F 2 1 Y 101/02 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 3/46 Z

H 0 5 K 3/46 U

H 0 5 K 3/46 X

H 0 5 K 3/46 Q

H 0 5 K 3/24 A

F 2 1 S 2/00 4 8 3

F 2 1 Y 101:02

【手続補正書】

【提出日】平成 26 年 7 月 25 日 (2014.7.25)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

基板と、

前記基板上に形成された第 1 絶縁層と、

前記第 1 絶縁層の第 1 主面上に形成された複数の配線パターンと、

前記第 1 主面上に形成され、前記配線パターンを被覆するとともに、隣接する前記配線パターンの一部をパッドとして露出する第 1 開口部を有する第 2 絶縁層と、

前記基板の前記第 1 開口部の形成された領域よりも外側の領域に形成され、前記基板が前記第 1 絶縁層に向かって厚さ方向に立ち上がって形成された突出部と、
を有し、

前記第 2 絶縁層は、光の反射層であることを特徴とする配線基板。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 2】

前記第 1 絶縁層上の前記外側の領域に形成され、金属又は金属合金からなる補強層を有し、

前記突出部は、前記補強層の形成された領域に形成されていることを特徴とする請求項 1 に記載の配線基板。

【手続補正 3】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 2】

基板と、

前記基板上に形成された第 1 絶縁層と、

前記第 1 絶縁層の第 1 主面上に形成された複数の配線パターンと、

前記第 1 主面上に形成され、前記配線パターンを被覆するとともに、隣接する前記配線パターンの一部をパッドとして露出する第 1 開口部を有する第 2 絶縁層と、

前記基板の前記第 1 開口部の形成された領域よりも外側の領域に形成され、前記基板が前記第 1 絶縁層に向かって厚さ方向に立ち上がって形成された突出部と、

前記パッド上に実装された発光素子と、

前記発光素子を封止するように形成された封止樹脂と、

を有し、

前記第 2 絶縁層は、光の反射層であることを特徴とする発光装置。

【手続補正 4】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1 3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1 3】

基板上に形成された第 1 絶縁層の第 1 主面上に配線パターンを含む配線層を形成する工程と、

前記配線パターン上に、隣接する前記配線パターンの一部をパッドとして露出する第 1 開口部を有し、光の反射層となる第 2 絶縁層を形成する工程と、

前記基板の前記第 1 開口部の形成された領域よりも外側の領域に、前記基板を前記第 1 絶縁層に向かって厚さ方向に立ち上げて突出部を形成する工程と、

を有することを特徴とする配線基板の製造方法。

【手続補正 5】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 5】

本発明の一観点によれば、基板と、前記基板上に形成された第 1 絶縁層と、前記第 1 絶縁層の第 1 主面上に形成された複数の配線パターンと、前記第 1 主面上に形成され、前記配線パターンを被覆するとともに、隣接する前記配線パターンの一部をパッドとして露出する第 1 開口部を有する第 2 絶縁層と、前記基板の前記第 1 開口部の形成された領域よりも外側の領域に形成され、前記基板が前記第 1 絶縁層に向かって厚さ方向に立ち上がって形成された突出部と、を有し、前記第 2 絶縁層は、光の反射層である。